

# 環境負荷化学物質含有量

環No.2019-ST44SW

2019年4月11日

製品名 : ST44SW  
部品質量 (mg) : 135

株式会社ステップテクニカ 管理部  
E-mail kanri\_step@steptechnica.com

部位	素材・化学物質	CAS No.	質量 (mg)	部位含有率 (wt%)	全体含有率 (wt%)	使用目的
チップ	シリコン (Si)	7440-21-3	3.1849	100	2.36	素子材料
チップマウント	銀 (Ag)	7440-22-4	0.131	74.9986	0.098	導電性材料
	エポキシ樹脂 (EP)	---	0.0436	25.0014	0.033	接合材料
リードフレーム	銅 (Cu)	7440-50-8	44.2485	100	32.81	フレーム材料
ワイヤ	金 (Au)	7440-57-5	0.606	100	0.045	配線
外部端子メッキ	パラジウム (Pd)	7440-05-3	0.0585	7.8	0.044	端子表面処理材料
	金 (Au)	7440-57-5	0.0225	3	0.017	端子表面処理材料
	ニッケル (Ni)	7440-02-0	0.6705	89.2	0.497	下地メッキ
パッケージ	三酸化アンチモン (Sb <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1309-64-4	1.74	2.02	1.289	封止樹脂難燃助剤
	PBB, PBDE 以外の臭素系難燃剤	---	1.305	1.52	0.967	封止樹脂難燃剤
	エポキシ樹脂 (EP)	---	15.225	17.69	11.33	封止樹脂材料
	シリカ (SiO <sub>2</sub> )	60676-86-0	67.7645	78.77	50.51	封止樹脂材料
		含有量合計	135		100	